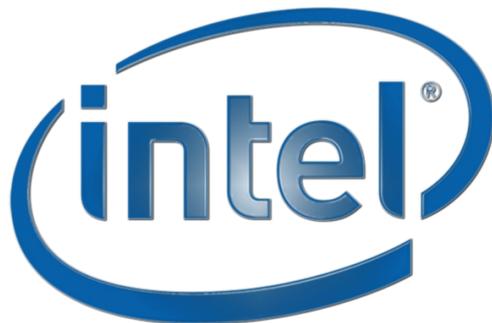




nexthardware.com

a cura di: Gian Paolo Collalto - giampa - 25-05-2021 14:00

## Nuovi socket e nuovi dissipatori in arrivo ...



**LINK (<https://www.nexthardware.com/news/processor-chipset/9380/nuovi-socket-e-nuovi-dissipatori-in-arrivo-.htm>)**

Le piattaforme Alder Lake e Ryzen 6000 potrebbero non essere compatibili con gli attuali sistemi di raffreddamento.



**Intel Comet Lake-S**  
(LGA1200) 37.5x37.5 mm



**Intel Alder Lake-S**  
(LGA1700) 37.5x45.0 mm

In base a quanto emerso nelle ultime ore, il futuro socket LGA 1700 dedicato alle CPU Alder Lake, che manderà in pensione l'attuale socket LGA 1200, avrà un'altezza inferiore di 1mm rispetto a quest'ultimo e anche una diversa disposizione dei fori per il montaggio dei dissipatori.



